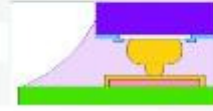


**DEUX TECHNOLOGIES D'ASSEMBLAGE POUR UNE FORTE MINIATURISATION**



**ICA**

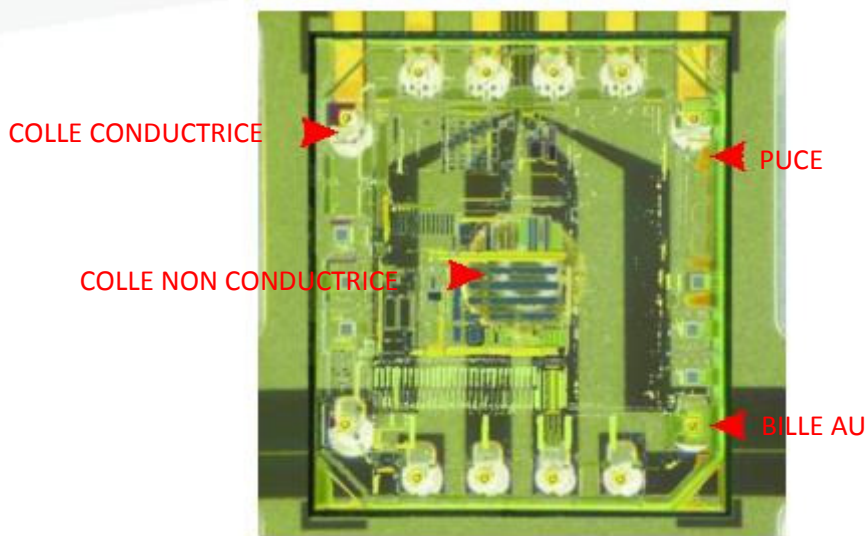
ISOTROPICAL CONDUCTIVE ADHESIVE(+UNDERFILL)



**NCP**

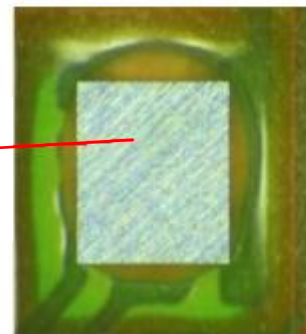
NON-CONDUCTIVE PASTE

**ICA / ISOTROPICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE**



NOUS SOMMES EN MESURE DE POSER DES FLIP-CHIP SUR DES MODULES ELECTRONIQUES CONFERMEMENT AUX SPECIFICATIONS DEFINIES EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT. CE TRAVAIL D'EQUIPE EST TRES IMPORTANT, SPECIALEMENT A LA PHASE LAYOUT. L'ASSEMBLAGE FLIP-CHIP PERMET A NOS CLIENTS D'ALLER PLUS LOIN DANS LA MINIATURISATION EN REDUISANT AU MAXIMUM LA PLAGE OCCUPEE PAR LES PUCES.

**NCP / NON-CONDUCTIVE PASTE**



COLLE NON CONDUCTRICE APRES THERMOCOMPRESSION